DMI Tech, 무전해 도금방식 FCCL 양산

디엠아이텍은 무전해 연속 도금공법으로 2층 연성동박적층필름(FCCL)을 양산하기 시작했다고 11월17일 발표했다.

디엠아이텍이 상용화한 무전해 연속 도금공법은 폴리이미드 수지(Polyimide Resin) 필름을 화학처리한 뒤 구리분자와 밀착시켜 연속적으로 도금하는 방식이다.

무전해 연속 도금공법으로 생산된 FCCL은 동박막을 1 μ m부터 조절할 수 있으며, 연성회로기판(FPCB)과 새로운 형태의 반도체 패키지인 COF(Chip on Film)를 가공할 때 니켈 성분이 전혀 없어 극미세피치(Fine-Pitch) 회로 설계도 가능하다.

FCCL은 연성인쇄회로기판과 COF의 필수소재로, 휴대폰과 디지털기기의 경박단 소화와 고기능화, 디스플레이 시장의 확대에 따라 수요가 크게 늘고 있다.

<화학저널 2005/11/18>